



## 大块非晶合金电子产品外壳的加工方法和加工装置

文献类型: 专利

**作者** 程明, 张士宏, 张海峰 and 王瑞雪

**发表日期** 2008-11-05

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明涉及电子产品外壳加工技术领域,具体地说是一种大块非晶合金电子产品外壳的加工方法和加工装置,克服现有大块非晶合金电子产品外壳加工技术中工艺复杂、铸造缺陷难以消除、壁厚不能过薄、产品性能难以满足更高的承载要求等不足,特别适合于笔记本电脑、手提摄像机、数码相机、手机、PDA、MP3 (MP4)、U盘等3C类电子产品外壳用薄壳形件的加工。利用大块非晶合金在过冷液相区的粘性流动行为,使合金变形并贴附于凹模内壁,完成薄壳形件的成形。加工装置包括上极板、大块非晶合金板坯、凹模等,大块非晶合金板坯置于上极板和凹模之间,在上极板中的压缩空...

**公开日期** 2008-11-05

**语种** 中文

**专利申请号** CN101298097

**源URL** [http://210.72.142.130/handle/321006/65886] [↓](#)

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 程明, 张士宏, 张海峰 and 王瑞雪. 大块非晶合金电子产品外壳的加工方法和加工装置. 2008-11-05.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
148	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。